

8414

Información Producto



translucent z-axis conductive heat activated film

Descripción del producto

tesa HAF® 8414 is a translucent heat-activated adhesive film that contains electrically conductive particles.

Características

- Chip module bonding and electrical connectivity in one step
- Good workability on all common implanting lines
- Suitable for PVC, ABS and PC cards (Dual Interface (D.I.) and contactless cards)
- Suitable for silver ink substrates and wire antenna
- Mean particle diameter: 40 µm

Aplicación

tesa HAF® 8414 is designed for all applications where reliable electrical connections and strong bonds are required. Lead applications are chip module embedding in Dual Interface (DI) cards and for RFID tags.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| • Material de soporte | ninguno | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | copoliámida | • Color | translúcido |

Información adicional

Processing:

Please note that optimal parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies, antenna material or chip-modules as well as individual customer requirements. The bonding time depends on the heat transition of the used substrates. Additionally we recommend a cooling step directly after the bonding step. Thereby pressure should be applied until film temperature decreases below softening temperature (approx. 110 °C).

The following data are recommendations for the initial set-up of machine parameters.

1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. An accurate pre-lamination is in particular important for tesa HAF® 8414 in order to ensure a good adhesion and a good conductivity inside of the final product.

Machine setting:

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=08414>



8414

Información Producto

Información adicional

- Temperature 130 - 150 °C
- Pressure 3 - 4 bar
- Time 2.5 m/min.

2. Conductive Bonding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die-cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. Depending on the type of the implanting line, single step or multiple step process can be used. Today, most implanting machines have multiple heat press steps.

Single step process - Machine setting:

- Temperature¹ 160 – 220 °C
- Pressure 65 - 130 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature¹ 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 130N/module
- Time 2 x 0,7 s. / 3 x 0.5 s.

¹Temperature recommendations refer to what can be measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- PVC 180 – 190 ° C
- ABS 180 – 190 ° C
- PET 190 – 200 ° C
- PC 200 – 220 °C

To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry. Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.



8414

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página
<http://l.tesa.com/?ip=08414>